



晶圓外觀 檢查機

定位精度
10um

檢測精度
1.1um

最小檢出
3um

更多產品

印刷電路板檢測系列、平面顯示器檢測系列

半導體檢測系列、隱形眼鏡檢測系列、鋰電池檢測系列



www.shyawei.com.tw

翔緯光電股份有限公司

TEL: 02-2668-7335 FAX: 02-2668-4322

E-MAIL: service@wisforce.com.tw ADD: 238 新北市樹林區佳園路二段59-6號



晶圓外觀 檢查機



伺服馬達軸搭配光學尺，其往復定位精度於 $\pm 10\mu\text{m}$ ，提供光學模組精準定位。



Wafer治具使用多孔真空吸附，可將Wafer平整吸附，提升定位精度需求。

機台型號	W150 / W200 / W300
樣品樣式	晶圓
樣品尺寸	6吋 / 8吋 / 12吋
設備尺寸	1800(L)x1700(W)x2100(H)mm / 2500(L)x1800(W)x2200(H)mm
操作模式	Auto
入料方式	Operator / Cassette
出料方式	Operator / Cassette
控制方式	PLC / PC
檢測方式	Area scan
Cycle time	雙工位 / 雙鏡頭→<600sec / sheet(不含Ink時間) Ink→1秒/次 (實際需要依照產品訂定)

晶圓外觀自動檢查系統，整合光學及視覺專業技術，提供完善的解決方案，其穩定的模組化機構大幅縮減後勤維護時間，非常適合高品質低成本的檢測需求。多組LED光源切換，可應對各式晶圓製程材料所造成的光學變化，以獲得最佳的瑕疵影像，廣泛應用於各式晶圓問題之檢測。獨特的檢測技術適用於晶圓製程，可有效檢測切割碎裂、bump / pad刮傷、異色、遺失、偏移、變形及外物等等。系統可與離線複檢站搭配使用，提升檢測產能。